

半導體矽晶圓

加工油劑

ユシロンテック

YUSHIRON TEC



三宜油化股份有限公司

SAN-I CHEMICAL CO., LTD.

YUSHIRON TEC

半導體的晶圓加工油劑 · 水溶性



產品介紹

PRODUCT DESCRIPTION

品名	性狀				特點及摘要
	原液外觀	比重 15/4°C	黏度 mPa.s(25°C)	pH (原液)	
SDW-36B	微黃色半透明液	1.030	4.5	5.5	為一種Glycol Base水性稀釋型切割油劑，專為固定磨粒鑽石線切割技術而特別設計之油劑。
SW-11	近無色透明液	1.030	9.0	5.0	矽晶圓切割開方製程專用油。
SW-323	淡黃色透明液	1.120	24.0	6.4	適用於矽晶圓線切割機，以搭配研磨料粒子#1000~#1500作為漿料(slurry)分散之用途。
SW-331	微黃色透明液	1.121	26.5	6.4	適用於矽晶圓線切割機，以搭配研磨料粒子#1000~#1500作為漿料(slurry)分散之用途。
WL-667	微黃色透明液	1.105	20.0	6.4	適用於矽晶圓線切割機，以搭配研磨料粒子#1000~#1500作為漿料(slurry)分散之用途。

YUSHIRON TEC

半導體的晶圓加工油劑 · 不水溶性

產品介紹

PRODUCT DESCRIPTION

品名	性狀				特點及摘要
	原液外觀	比重 15/4°C	黏度 mPa.s(25°C)	引火點°C,COC	
HT-83	黃色不透明液	0.870	80.0	180	為半導體矽晶圓、水晶、陶瓷等在Slicing加工時所使用之漿料(Slurry)的基油(分散媒)，專為以Multi-Wire saw加工所開發出來的油性Type之油劑。
HT-85T	黃色不透明液	0.870	85.0	170	為半導體矽晶圓、水晶、陶瓷等在Slicing加工時所使用之漿料(Slurry)的基油(分散媒)，專為以Multi-Wire saw加工所開發出來的油性Type之油劑。